

Rede

von Staatssekretär Dr. Andreas Handschuh,
Chef der Sächsischen Staatskanzlei,
am 25.09.2026 im Deutschen Bundesrat

zum TOP 71

Vorschlag für eine Verordnung über einen
Rahmen für Maßnahmen zur Stärkung des
Halbleiterökosystems der Union
(Chip-Verordnung 2.0)

Redezeit: [6-7 Minuten]

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wer über die Zukunftsfähigkeit Europas spricht, muss über Halbleiter sprechen.

Wer über technologische Souveränität spricht, muss über Halbleiter sprechen.

Und wer über die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie spricht, muss über Halbleiter sprechen.

An Halbleitern kommt man also nicht vorbei.

Die Europäische Kommission hat am 3. Juni 2026 mit dem European Chips Act 2.0 einen Verordnungsvorschlag vorgelegt, der von erheblicher wirtschafts- und industriepolitischer Bedeutung für unsere Länder und für die gesamte Europäische Union ist.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Abhängigkeit Europas von der Halbleiterfertigung in Drittstaaten ist uns spätestens in der Halbleiterkrise in den Jahren 2021 und 2022 schmerzhaft vor Augen geführt worden.

Die europäische Automobilindustrie verlor damals durch die Chip-Knappheit nahezu 100 Mrd. EUR an Umsatz. Weltweit konnten 18 Mio. Fahrzeuge nicht produziert werden.

Allein in Deutschland sank die Pkw-Produktion 2021 auf das niedrigste Volumen seit 1975.

Und dies, obwohl die Nachfrage nach europäischen Autos ungebrochen war. Es fehlte schlicht an den richtigen Chips.

Diese Erfahrung hat uns eines gelehrt: Halbleiter sind eine strategische Ressource.

Sie stecken in Autos, in Maschinen, in medizinischen Geräten, in Rechenzentren, in Energieinfrastrukturen und in unzähligen weiteren Produkten, die unseren Alltag und unsere Industrie prägen.

Eine Unterbrechung der Lieferketten hat unmittelbare Auswirkungen auf Arbeitsplätze, auf Wertschöpfung und auf unseren Wohlstand.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

mit Blick auf den European Chips Act 2.0 sind zwei Dinge wichtig.

Erstens werden die Maßnahmen des ECA 1 im Lichte der Erfahrungen, die man seit 2023 gemacht hat, aktualisiert. Der ECA 2 spiegelt also die Lernkurve der EU wider, jedenfalls teilweise – dazu später mehr.

Vor allem geht es zweitens um eine Neuausrichtung der europäischen Industriepolitik für Halbleiter.

Es geht um die Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit, der technologischen Souveränität und der Resilienz in diesem Sektor.

Zukunftsorientiertes Handeln statt reaktiver Krisenbewältigung ist die Devise dieser Vorlage.

Der Verordnungsvorschlag erweitert den Chips Act von 2023 um wichtige neue Instrumente:

Erstens um eine stärkere Nachfrageorientierung, die den Marktzugang europäischer Chip-Hersteller sichert;

Zweitens geht es um eine Stärkung der gesamten Wertschöpfungskette mit explizitem Fokus auf alle Stufen – von Rohstoffen und Werkstoffen über Design, Maschinen und Fertigung bis zum Packaging.

Drittens sieht der Verordnungsentwurf, Beschleunigungsmechanismen für Genehmigungsverfahren strategischer Projekte vor.

Und er etabliert viertens ein Gütesiegel für Halbleiterregionen der Exzellenz.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

der Freistaat Sachsen hat zu dieser Vorlage einen Antrag in den Wirtschafts- und Europa-Ausschuss des Bundesrates eingebracht.

Unser Antrag greift zentrale Positionen auf:

- die Stärkung von Forschungsinfrastrukturen und Pilotlinien als Schnittstelle zwischen Forschung und Industrie,
- die Ausweitung von „First-of-a-Kind“-Projekten auf die gesamte Wertschöpfungskette,

- die Berücksichtigung bestehender Halbleiterstandorte in Deutschland,
- die Beschleunigung der EU-beihilferechtlichen Prüfverfahren,
- die Verknüpfung des Gütesiegels mit konkreten Förder- und Verfahrensvorteilen
- sowie die Klärung des EU-Finanzierungsrahmens.

Zwei Punkte möchte ich besonders hervorheben:

Erstens: Geschwindigkeit ist alles in der Halbleiterwelt.

Überbordende Bürokratie, ein hoher Verwaltungsaufwand bremsen dagegen – ich denke, über diesen Punkt herrscht Konsens.

Fraglich ist daher, weshalb der Entwurf der Kommission keine Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung von EU-beihilferechtlichen Prüfverfahren enthält.

Es gibt Anträge nach dem ECA 1, die seit 18 Monaten geprüft werden und immer noch nicht beschieden sind. Das darf es beim ECA 2 nicht mehr geben.

Kritisch ist auch anzumerken: Der Entwurf für das ECA 2 adressiert primär die Mitgliedstaaten. Dabei werden auf Länderebene die Genehmigungsverfahren bereits zügig erledigt. Zeitliche Verzögerungen ergeben sich gegenwärtig vor allem aus EU-beihilferechtlichen Verfahren. Angebracht ist daher eine gezielte Verfahrensbeschleunigung auf EU-Ebene.

Zweiter Punkt: Die Frage nach dem EU-seitigen Finanzierungsrahmen ist unzureichend geklärt.

In der Vorlage sind lediglich 70 Mio. EUR für eine Business-to-Business-Plattform eingeplant.

Wer aber strategische Projekte im Umfang von über 80 Mrd. Euro – wie den Aufbau einer europäischen Fertigung für fortgeschrittene Halbleiter oder für Speicherchips – ins Schaufenster stellt, muss sich auch an der Finanzierung beteiligen.

Daher muss schnell – Stichwort:
Geschwindigkeit – Klarheit über
verfügbare Mittel und die
langfristige
Finanzierungsperspektive
geschaffen werden – und zwar im
Mehrjährigen Finanzrahmen.

Meine sehr geehrten Damen und
Herren,

der European Chips Act 2.0 ist von
herausgehobener Bedeutung,
weil er über die Zukunftsfähigkeit
der europäischen
Halbleiterindustrie entscheidet.

Halbleiter sind eine
Schlüsseltechnologie des 21.
Jahrhunderts.

Wer bei Halbleitern nicht mithalten kann, wird

- bei künstlicher Intelligenz,
- bei autonomen Fahrzeugen,
- bei der Energiewende und
- bei unzähligen weiteren Zukunftstechnologien

ins Hintertreffen geraten.

Das darf und das muss uns nicht passieren.

Europa hat starke Forschungslandschaften, leistungsfähige Unternehmen und gewachsene Halbleiterökosysteme.

Der European Chips Act 2.0 bietet die Chance, diese Stärken gezielt auszubauen und Europa zu einem wettbewerbsfähigen, resilienten und technologisch souveränen Halbleiterstandort zu machen.

Unsere Stellungnahme trägt dazu bei, diese Chance zu nutzen.

Sie bringt die Positionen der Länder in das Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene ein und sorgt dafür, dass unsere Interessen bei der weiteren Ausgestaltung der Chip-Verordnung 2.0 angemessen berücksichtigt werden.

Sie ergänzt die Stellungnahmen des Europäischen Parlaments und des Ausschusses der Regionen, die federführend von sächsischen Europaabgeordneten bzw. dem früheren Staatsminister Thomas Schmidt vorbereitet werden und in die gleiche Richtung gehen.

Vereint haben wir die Chance, dass der ECA 2 deutlich besser wird und Deutschland als Halbleiterstandort entscheidend stärkt.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.